



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号

西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20090113001B

2009 年 9 月 9 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

ASP(アプリケーションスペシフィックプロダクト) 一部製品 前処理サイト変更のご案内
(認定済 11 製品への追加認定 30 製品の連絡)

(第二版 PCN20090113001A 2009 年 9 月 3 日発行, 初版 PCN20090113001 2009 年 3 月 18 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice
変更概要	Design/Specification	☐ Design ☐ Electrical ☐ Mechanical
	☒ Wafer Fab	☒ Site ☐ Process ☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	Assembly	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	Test	☐ Site ☐ Process
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling ☐ -
変更内容	下記変更について認定済 11 製品への追加認定 30 製品の連絡になります。 ASP 一部製品 前処理サイト変更 現行：TI-MIH06(日本)サイト 変更後：TI-HIJI(日本)サイト	
対象製品	対象製品リスト参照	
変更時期	追加認定品は 12 月中旬より予定しています。 6 月下旬より実施しています。 (追加認定品のサンプル出荷は、10 月中旬より予定しています。) (サンプル出荷は、4 月下旬より実施しています。)	
品質認定試験	☐ 計画	☒ 終了
製品表示	☐ 変更無し	☒ 変更あり
備考	－	

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容：今回のお知らせは、下記変更について認定済 11製品への追加認定 30製品の連絡になります。弊社 ASP (アプリケーションスペシフィックプロダクト) 一部製品 前処理サイトについて、現行 TI-MIH06 (日本) サイトにて製造いたしておりますが、TI-MIH06 サイト製造終了の為、これに替えて、TI-HIJI (日本) サイトでの製造に移行し認定しました。尚、今回の変更で、製品についての互換性 (寸法/公差), 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
前処理サイト	TI-MIH06 (日本)	TI-HIJI (日本)

理由：TI-MIH06 サイト製造終了の為

対象製品リスト

対象製品名				
■：追加認定品 □：認定完了品				
D12945PN	TMS320BC51PQ80	TMS320BC52PJ57	TMS320BC53PQ80	TMS320LBC51PZA57
D17222PZ	TMS320BC51PQA57	TMS320BC52PJ80	TMS320BC57SPGE57	TMS320LBC52PZA57
D172B1PJ92G4	TMS320BC51PQA80	TMS320BC52PJA57	TMS320BC57SPGE80	TMS320LC50PQ50
D17807PJ	TMS320BC51PQA80G4	TMS320BC52PZ100	TMS320C209PN57	TMS320LC50PQ57
D17807PJR	TMS320BC51PZ100	TMS320BC52PZ57	TMS320C50PGEA57	TMS320LC50PQA
D17807PJRG4	TMS320BC51PZ57	TMS320BC52PZ80	TMS320C50PQ57	
D72931PN	TMS320BC51PZ80	TMS320BC52PZ80G4	TMS320C50PQ80	
TMS320BC51PQ100	TMS320BC51PZA57	TMS320BC52PZA57	TMS320C50PQA57	
TMS320BC51PQ57	TMS320BC52PJ100	TMS320BC53PQ57	TMS320LBC51PQA57	

製品表示

この変更に伴い、製品捺印の FAB CODE が "H" (TI-MIH06) から "J" (TI-HIJI) に変更されます。

信頼性試験

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2009 年 8 月 26 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Device:	D12945PN	-	-	
Wafer Fab:	HIJI	Wafer Technology:	50C18.23	
Assembly Site:	PHI	Package Code/Pins:	PN/80	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
**Autoclave	121C,168 Hours		231/0	
**Temp Cycle	-65/150C, 1000cyc		201/0	
Life Test	125C/6.5V, 1000 Hours		348/0	
**Storage Bake	150C,1000 Hours		231/0	
ESD-HBM	+/-2.0 kV		9/0	
CMOS Latch-up	+/-250 mA per I/O, 7.5Vccmax at room temp		15/0	
Manufacturability	per mfg. site specification		Approved	
Notes: ** Test requires Moisture Preconditioning. JEDEC Level-1/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2009 年 8 月 26 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Device:	D17807PJ	-		-
Wafer Fab:	HIJI	Wafer Technology:		50C18.22
Assembly Site:	PHI	Package Code/Pins:		PJ/100
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
**Autoclave	121C,240 Hours		231/0	
**Temp Cycle	-65/150C, 1000cyc		201/0	
ESD-HBM	+/-2.0 kV		9/0	
CMOS Latch-up	+/-250 mA & 2x Vcc		15/0	
Manufacturability	per mfg. site specification		Approved	
Notes: ** Test requires Moisture Preconditioning, JEDEC Level-4/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2009 年 8 月 26 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Device:	D172B1PJ92G4	-	-	
Wafer Fab:	HIJI	Wafer Technology:	50C18.22	
Assembly Site:	PHI	Package Code/Pins:	PJ/100	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
ESD-HBM	+/-2.0 kV		9/0	
CMOS Latch-up	+/-250 mA & 2x Vcc		15/0	

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2009 年 8 月 26 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Device:	TMS320C50PQ57	-	-	
Wafer Fab:	HIJI	Wafer Technology:	50C18.22	
Assembly Site:	PHI	Package Code/Pins:	PQ/132	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
**Autoclave	121C,240 Hours		231/0	
**Temp Cycle	-65/150C, 1000cyc		231/0	
ESD-HBM	+/-2.0 kV		9/0	
CMOS Latch-up	+/-200mA & 1.5x Vmax		15/0	
Manufacturability	per mfg. site specification		Approved	
Notes: ** Test requires Moisture Preconditioning, JEDEC Level-4/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2009 年 8 月 26 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Device:	TMS320C50PGEA57	-	-	
Wafer Fab:	HIJI	Wafer Technology:	50C18.22	
Assembly Site:	PHI	Package Code/Pins:	PGE/144	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
Manufacturability	per mfg. site specification		Approved	

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2009 年 8 月 26 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Device:	TMS320BC51PQ100	-	-	
Wafer Fab:	HIJI	Wafer Technology:	50C18.22	
Assembly Site:	PHI	Package Code/Pins:	PQ/132	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
ESD-HBM	+/-2.0 kV		9/0	
CMOS Latch-up	+/-250 mA & 2x Vcc		15/0	

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2009 年 8 月 26 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Device:	TMS320BC51PZ100	-	-	
Wafer Fab:	HIJI	Wafer Technology:	50C18.22	
Assembly Site:	PHI	Package Code/Pins:	PZ/132	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
Manufacturability	per mfg. site specification		Approved	

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2009 年 8 月 26 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Device:	TMS320BC53PQ57	-	-	
Wafer Fab:	HIJI	Wafer Technology:	50C18.12	
Assembly Site:	PHI	Package Code/Pins:	PQ/132	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
ESD-HBM	+/-2.0 kV		3/0	
CMOS Latch-up	+/-250 mA & 2x Vcc		5/0	

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2009 年 8 月 26 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Device:	TMS320BC57SPGE57	-	-	
Wafer Fab:	HIJI	Wafer Technology:	50C18.22	
Assembly Site:	PHI	Package Code/Pins:	PGE/144	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
ESD-HBM	+/-2.0 kV		3/0	
CMOS Latch-up	+/-250 mA & 2x Vcc		5/0	